

2021年4月19日

**報道関係各位**

**PALTEK** SOLUTION SUPPLIER  
**PALTEK**  
プレスリリース  
株式会社 P A L T E K

## 紙が物流コストと環境問題を変えていく PALTEK、次世代 EC&店舗 EXPO【春】に出展

株式会社 P A L T E K（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：高橋忠仁、証券コード：7587、以下 P A L T E K）は、2021年4月26日（月）から4月28日（水）まで、東京ビッグサイトで開催される「第30回 Japan IT Week 春 内、次世代 EC&店舗 EXPO【春】」に出展し、「紙が物流コストと環境問題を変えていく」をテーマに、Ranpak 株式会社（以下 Ranpak）の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進について提案します。

新型コロナウイルスの感染拡大に影響により、EC・物流業界は大きく様変わりしました。巣ごもり需要の増加などによりネットショッピングの利用が拡大し、物流量は大幅に増加しています。これに伴い、EC 事業者や物流事業者では出荷作業のオートメーション化などの物流生産性向上が求められています。また、世界的な「脱プラスチック」の流れは加速しており、プラスチック系の梱包資材の使用を控える動きなども顕著になっています。



展示会出展ブースイメージ

P A L T E K が提供する Ranpak の紙梱包資材はプラスチック製品の梱包資材の置き換えが可能のため、食品や雑貨・日用品を扱う通信販売や実店舗での採用に加え、電子機器などの精密機器や医薬品など、さまざまな商品の緩衝材として採用が広がっています。Ranpak の紙梱包資材は、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小、梱包作業の高速化による労働コストの削減などのトータルコストの大幅な削減が可能となります。

「次世代 EC&店舗 EXPO【春】」は、通販支援サービスや店舗運営・集客・接客ソリューション、ネットと実店舗の連携サービスなどの製品が多数出展する展示会です。PALTEKブースでは2020年6月に日本国内で販売を開始した次世代緩衝材システム「PadPak®Guardian」の実演や、ラッピングシステムなどについて展示をし、Ranpakの紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進を提案します。また、新たに梱包自動化ソリューションとして、資材コスト・季節による需要の変動・パレットの積載効率・積荷の最適化など、お客様のコスト全体に影響を及ぼす要素の改善を提案します。

## ■ 展示会の概要

展示会名	:	次世代EC&店舗 EXPO【春】
開催日時	:	2021年4月26日(月)から4月28日(水) 10:00~18:00 (最終日のみ17:00まで)
会場	:	東京ビッグサイト西展示棟1F (東京都江東区有明3-11-1) PALTEKブースは、7-36
主催	:	リード エグジビション ジャパン株式会社
展示会URL	:	<a href="https://www.japan-it-spring.jp/ec/">https://www.japan-it-spring.jp/ec/</a>
無料招待券URL	:	<a href="https://www.japan-it-spring.jp/ec_ex_einv_emv/">https://www.japan-it-spring.jp/ec_ex_einv_emv/</a>
URL	:	(入場には招待券が必要です。招待券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000/人)

# 第9回 次世代EC&店舗 EXPO 春

## ■ 主な出展内容

### ・次世代緩衝材システム:PadPak®Guardian

「PadPak®Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。これにより、電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。



次世代緩衝材システム  
「PadPak®Guardian」

▼詳細は、以下URLよりご確認ください。

[https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak\\_guardian/index.html](https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak_guardian/index.html)

### ・高速すき間埋めシステム:FillPak®

「FillPak®」は、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。



高速すき間埋めシステム「FillPak®」

▼詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/index.html>

## ・ラッピングシステム:Geami WrapPak®

「Geami WrapPak®」は、特許を取得したダイカット（切り込み）入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。



▼詳細は、以下URLよりご確認ください。

[https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami\\_wrappak/index.html](https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_wrappak/index.html)

ラッピングシステム「Geami WrapPak®」

## ・梱包自動化ソリューション

梱包自動化ソリューションの一つである、「Pad'it!」は、梱包ラインの効率を高める、特殊な自動梱包機です。高品質な紙緩衝材を直接箱にセットすることにより、輸送中の壊れやすい製品を保護します。箱の底サイズに合わせ、1時間あたり最大900箱に紙緩衝材を作成し、製品保護を改善し自動化します。消費材、美容・ヘルスケア、事務用品、グラフィックアート、電気/電子機器、工具・機器類など幅広い業界で使用されています。



梱包自動化ソリューション

▼詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.ranpak.com/jp/automation-solutions/>

## ■ Ranpak株式会社について

Ranpakは世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。Ranpak BVは、欧州およびアジアに100以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリスなど）の成熟市場、東ヨーロッパ（ポーランド、スロバキア、トルコ）の発展途上市場、およびアジア太平洋（オーストラリア、日本、シンガポールなど）など、世界中に拠点があります。

Ranpakに関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

## ■ 株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

---

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社 P A L T E K

担当者： 広報担当 柴崎、寺田

メールアドレス： [pr@paltek.co.jp](mailto:pr@paltek.co.jp)

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話： 045-477-2072

2：本展示会に関するお問い合わせ

株式会社 P A L T E K

担当者： 次世代 EC&店舗 EXPO【春】担当者

メールアドレス： [info\\_pal@paltek.co.jp](mailto:info_pal@paltek.co.jp)

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話： 045-477-2009